

D4SBN20

200V 4A

特長

- 薄型SIPパッケージ
- SBDブリッジ
- 低VF・低IR

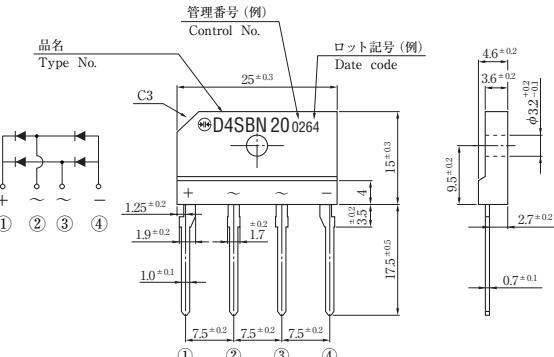
Feature

- Thin-SIP
- SBD Bridge
- Low VF · Low IR

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Package : 3S

Unit : mm
Weight : 3.9g (typ.)



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

■定格表 RATINGS

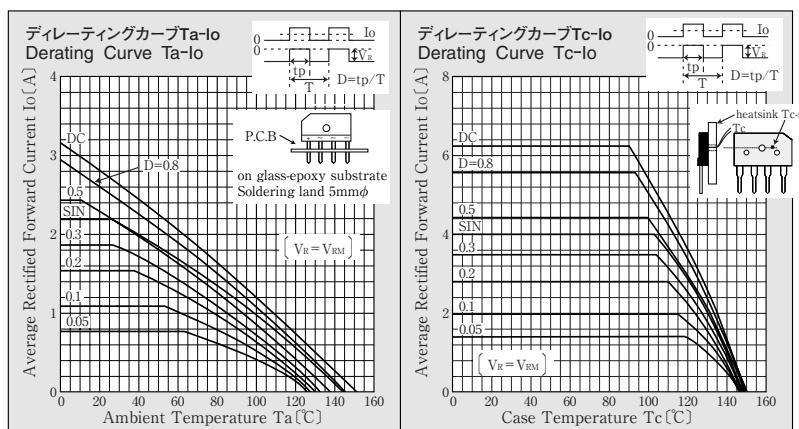
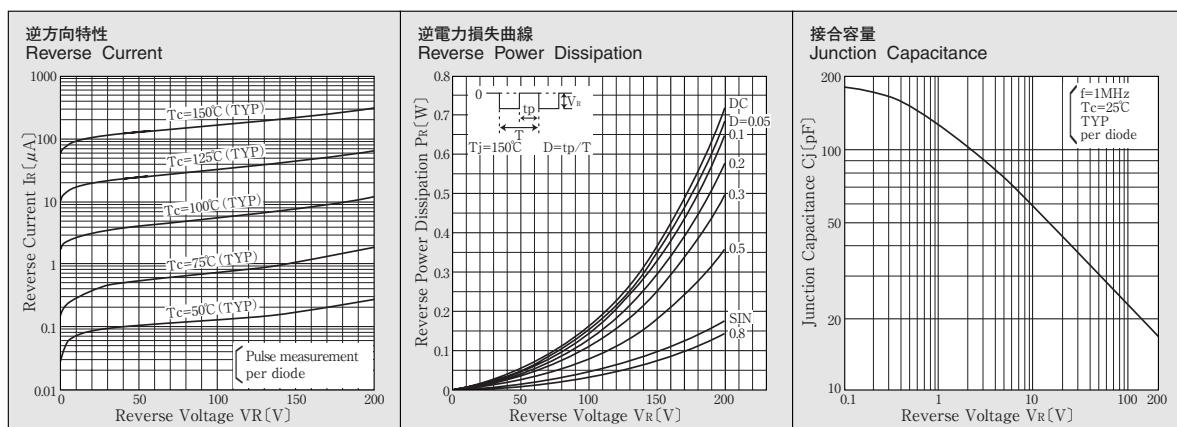
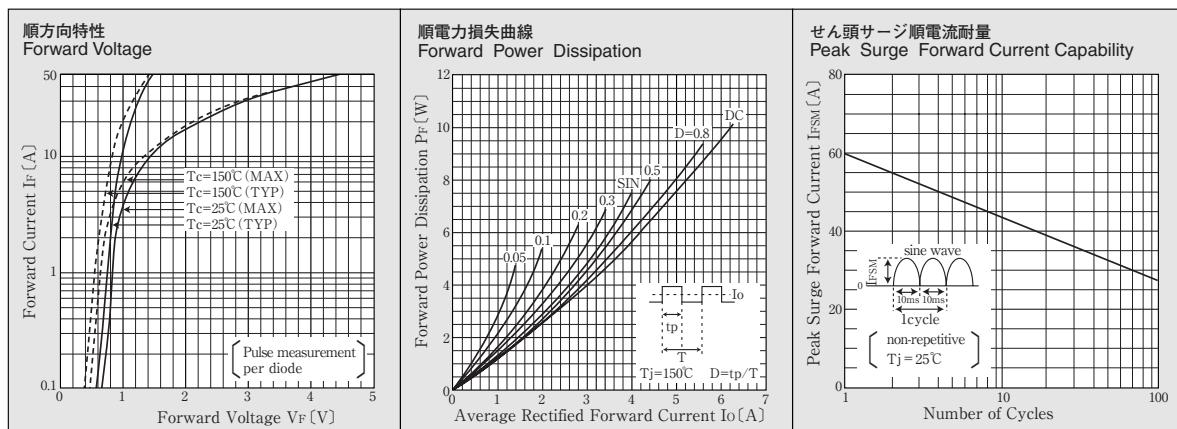
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D4SBN20	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink Tc=103°C フィンなし Without heatsink Ta=25°C	4.0 2.2	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25°C		60	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	Vdis	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2.0	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.5 N·m) (Recommended torque : 0.5 N·m)		0.8	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=2A, VR=200V, f=1MHz, VR=10V, θ_{jc} , θ_{jl} , θ_{ja}	Pulse measurement, one diode per diode	MAX 0.90	V
逆電流 Reverse Current	IR		Pulse measurement, one diode per diode	MAX 1.5	μA
接合部容量 Junction Capacitance	Cj		one diode per diode	TYP 60	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間, フィン付き junction to case, With heatsink		MAX 6.0	°C/W
	θ_{jl}	接合部・リード間 junction to lead		MAX 8.0	
	θ_{ja}	接合部・周間間 junction to ambient		MAX 35	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- Sine waveは50Hzで測定しています。
- 50Hz sine wave is used for measurements.
- 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typicalは統計的な実力を表しています。
- Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.